

Title (en)
DISTRIBUTION DEVICE AND METHOD FOR APPLYING ADHESIVES TO PLATES

Title (de)
VERTEILVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERTEILEN VON KLEBSTOFFEN AUF PLATTEN

Title (fr)
DISPOSITIF DE DISTRIBUTION ET PROCÉDÉ DE DISTRIBUTION D'ADHÉSIFS SUR DES PLAQUES

Publication
EP 3608487 A1 20200212 (DE)

Application
EP 18187732 A 20180807

Priority
EP 18187732 A 20180807

Abstract (en)
[origin: WO2020030658A1] The invention relates to a distribution device (10) for distributing liquid, paste-like or viscous adhesives on plates, particularly the bonding sides of plates, preferably tiles, particularly preferably tiles of varying size, said device comprising a base element (11) and two guide elements (13), particularly lateral guide elements (13), for guiding the plates. According to the invention, the distribution device (10) comprises a distribution element (12) for distributing the adhesive on the plate. The distribution element (12) is connected or can be connected particularly directly or indirectly to the base element (11). The distribution device (10) particularly comprises a receiving region (14), a guide region (15) and a removal region (16) for receiving, guiding and removing the plates.

Abstract (de)
Verteilvorrichtung (10) zum Verteilen von flüssigen, pastösen oder zähflüssigen Klebstoffen auf Platten, insbesondere Klebseiten von Platten, bevorzugt Fliesen, insbesondere bevorzugt Fliesen von verschiedener Grösse, umfassend ein Basiselement (11) und zwei Führungselemente (13), insbesondere seitliche Führungselemente (13), zur Führung der Platten. Die Verteilvorrichtung (10) umfasst ein Verteilelement (12) zum Verteilen des Klebstoffes auf der Platte. Das Verteilelement (12) ist insbesondere direkt oder indirekt mit dem Basiselement (11) verbunden oder verbindbar. Die Verteilvorrichtung (10) umfasst insbesondere einen Aufnahmebereich (14), einen Führungsbereich (15) und einen Entnahmebereich (16) zur Aufnahme, Führung und Entnahme der Platten.

IPC 8 full level
E04F 21/02 (2006.01); **B05C 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)
E04F 21/023 (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)
CN 107327125 A 20171107 - MCC5 GROUP SHANGHAI CORP LTD

Citation (search report)
• [X] US 2329378 A 19430914 - ALBERT KUEHNER ROBERT
• [X] DE 3726841 A1 19890223 - RAUPACH UDO [DE]
• [X] WO 2005026468 A1 20050324 - PETINI GINO [IT]
• [X] BE 682328 A 19661114
• [X] FR 2702972 A1 19940930 - BONALDO ALAIN [FR]
• [X] CN 107327125 A 20171107 - MCC5 GROUP SHANGHAI CORP LTD
• [X] US 4967689 A 19901106 - WITTMANN THOMAS P [US], et al

Cited by
CN112576018A; CN11426333A

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3608487 A1 20200212; EP 3833830 A1 20210616; US 2021310260 A1 20211007; WO 2020030658 A1 20200213

DOCDB simple family (application)
EP 18187732 A 20180807; EP 19746521 A 20190806; EP 2019071155 W 20190806; US 201917266165 A 20190806